

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2026-044

转债代码：118065

转债简称：艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司

关于部分募投项目结项及注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“发展与科技储备资金”已完成并达到预定可使用状态，公司于近日将其进行了结项并注销了募集资金专户，节余募集资金利息1.06万元（利息扣减手续费等）已全部转入公司银行账户用于永久补充流动资金。同时，公司于近日已将“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”等已结项项目的节余募集资金利息36.29万元（利息扣减手续费等）全部转入募投项目“高性能模拟芯片研发和产业化项目”并注销了相应的募集资金专户。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本次部分募投项目结项及注销部分公司首次公开发行股票募集资金专户事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月4日出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股4,180万股，每股发行价格为76.58元，募集资金总额为人民币3,201,044,000元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述募集资金已于2021年8月10日全部到账并经大信会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2021】第4-00042号《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目计划

根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金投入 金额(万元)
1	智能音频芯片研发和产业化项目	44,164.59	44,164.59
2	5G射频器件研发和产业化项目	21,177.05	21,177.05
3	马达驱动芯片研发和产业化项目	36,789.12	36,789.12
4	研发中心建设项目	40,824.76	40,824.76
5	电子工程测试中心建设项目	73,858.20	73,858.20
6	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00
合计		246,813.72	246,813.72

公司分别于2023年4月13日、2023年5月11日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议及2022年年度股东大会，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用剩余全部超募资金47,220万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述新项目计划投资总额为47,747.45万元，拟使用剩余超募资金47,220万元及其衍生利息、现金管理收益，剩余资金以自有资金补足。项目具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金投入 金额(万元)
1	高性能模拟芯片研发和产业化项目	47,747.45	47,220.00
合计		47,747.45	47,220.00

由于“电子工程测试中心建设项目”的建设周期长、技术挑战多、开发复杂度高，需要配备大量高素质技术人员，同时建设测试生产线，提升公司芯片测试的产

能，确保公司在未来半导体发展的局势中占据行业主导地位。公司拟将“研发中心建设项目”结项后的剩余募集资金18,932.47万元及其衍生利息、现金管理收益，用于“电子工程测试中心建设项目”。

公司分别于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资总额由40,824.76万元变更为21,892.29万元，使用募集资金拟投入金额由40,824.76万元变更为21,892.29万元，为进一步提高募集资金使用效率拟将“研发中心建设项目”调整后的剩余募集资金用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的公告》（公告编号：2023-053）。

2024年4月8日，本公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》，因外部环境变化，公司无法与临港规资处有效沟通导致拿地方案的审批推迟，亦无法与政府部门各委办单位有效沟通导致并联征询批复意见延缓。在取得产证后根据主管部门对用地地块的设计要求，设计单位重新对施工图进行调整修改，建设规模超过原先体量，项目新增设计两层地下室，整体施工周期增加，并需要主管部门对设计方案及施工组织方案重新进行专家评审，导致项目建设周期拉长，本项目投产时间也将随之顺延，董事会同意对“电子工程测试中心建设项目”将原计划达到预订可使用状态日期2024年8月延期至2026年3月。（公告编号：2024-022）。

2025年7月27日，本公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》，由于市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目拟投资金额进行调整，公司拟加大对55nm和40nmBCD先进工艺导入的投入，根据对未来投入规划的测算，将募投项目延期至2026年8月，以实现募投项目建设基础平台性及前瞻性的技术的目标。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。（公告编号：2025-035）。

2025年8月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次

会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，“高性能模拟芯片研发和产业化项目”原计划达到预定可使用状态日期为2026年6月，在综合考量当前市场需求、募投项目进度、更有效利用募集资金和公司长期发展规划后，将“高性能模拟芯片研发和产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2027年12月。保荐人就此事出具了明确的核查意见。（公告编号：2025-043）。

（二）募集资金专户开立与管理情况

账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
上海艾为微电子技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121939323310888	已注销
上海艾为电子技术股份有限公司	招商银行上海分行营业部	121928744310666	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001344792	本次注销
上海艾为电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501352188	本次注销
上海艾为电子技术股份有限公司	中国银行上海市吴中路支行	439081861450	本次注销
上海艾为半导体技术有限公司	上海银行闵行支行	03004644696	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	上海银行闵行支行	03004644378	本次注销
上海艾为微电子技术有限公司	中信银行上海分行营业部	8110201012101685873	本次注销
上海艾为微电子技术有限公司	上海银行闵行支行	03005501767	本次注销
上海艾为微电子技术有限公司	中国银行上海市吴中路支行	446885714103	本次注销
上海艾为微电子技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121939323310118	使用中
成都艾为微电子科技有限公司	上海银行闵行支行	03005824825	使用中
无锡艾为集成电路技术有限公司	上海银行闵行支行	03005824795	使用中
苏州艾为集成电路技术有限公司	上海银行闵行支行	03005824817	使用中
上海艾为微电子技术有限公司	上海银行闵行支行	03005824787	使用中
上海艾为集成电路技	招商银行上海分行营业	121941213410012	使用中

术有限公司	部		
上海艾为半导体技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121939330310013	使用中
深圳艾为集成电路技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121944966010017	使用中
合肥艾为集成电路技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121945865310018	使用中
哈尔滨艾为微电子技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121953529210020	使用中
大连艾为微电子技术有限公司	招商银行上海分行营业部	411910565110021	使用中
北京艾为微电子技术有限公司	招商银行上海分行营业部	121980045910022	使用中

三、本次结项募投项目募集资金使用及专户注销情况

公司募投项目“发展与科技储备资金”已完成并达到预定可使用状态，公司于近日将其进行了结项并注销募集资金专户（中信银行股份有限公司上海分行8110201013501352188），节余募集资金利息1.06万元（利息扣减手续费等）已全部转入公司银行账户用于永久补充流动资金。截至本公告披露日，本次结项募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额①	累计投入募集资金金额②	利息及理财收益（扣除手续费）③	节余募集资金金额④=①-②+③
1	发展与科技储备资金	30,000.00	30,335.39	336.45	1.06

注：募投项目累计已投入金额大于实际募集资金净额，系公司将该项目的募集资金利息收入及理财收益扣除手续费净额投入该项目中。

四、部分募集资金专项账户注销情况

鉴于公司于2025年8月12日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”已完成并达到预定可使用状态。截至2025年8月7日，“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”的

节余募集资金合计为21,043.78万元，截至2025年8月28日止，公司已将结余募集资金扣除已签订合同待支付款项968.20万元后的20,075.57万元用于投入到“高性能模拟芯片研发和产业化项目”，以满足市场需求及公司研发目标，提高公司募集资金使用效率。近日公司“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”已签订合同待支付款项已支付完毕，公司已将节余募集资金利息36.29万元（利息扣减手续费等）全部转入募投项目“高性能模拟芯片研发和产业化项目”并注销了相应的募集资金专户。

本次注销的募集专户如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
上海艾为电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001344792	本次注销
上海艾为电子技术股份有限公司	中国银行上海市吴中路支行	439081861450	本次注销
上海艾为电子技术股份有限公司	上海银行闵行支行	03004644378	本次注销
上海艾为微电子技术有限公司	中信银行上海分行营业部	8110201012101685873	本次注销
上海艾为微电子技术有限公司	上海银行闵行支行	03005501767	本次注销
上海艾为微电子技术有限公司	中国银行上海市吴中路支行	446885714103	本次注销

五、相关审核及批准程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本次事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。

六、其他说明

本公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。此次募投项目结项及办理注销部分募集资金专户后，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署对应的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026年6月27日